

Oberflächenmontierbare Bauelemente (SMD), Teil 1

	Seite
Vorwort	3
<i>Begründung der SMD-Technologie aus tech.-ökonomischer Sicht</i>	
Neue Tendenzen in der zukünftigen Technologieentwicklung durch oberflächenmontierbare Bauelemente und ihre Anwendung	6
<i>Einführung und Übersicht zur geplanten SMD-Technologie in der DDR, viele technische Einzelheiten zu SMD-BE, zahlreiche Tabellen</i>	
Standard- (Rahmen-) Technologie zur Herstellung gemischt bestückter Leiterplatten mit integriertem Dualitätssicherungssystem	20
<i>Beschreibung der technologische Grundkonzeption aus der Sicht einer Hauptanwender- Institution, viele Prinzipskizzen</i>	
SMD-Technik aus der Sicht der Standardisierung	29
<i>Überblick zum gegenwärtigen und zum erwartenden Stand</i>	
Erste Erfahrungen mit oberflächenmontierbaren Bauelementen im Zentrum Elektronischer Gerätebau der IH Mittweida	34
<i>Beschreibung der Labor-mäßigen „Handling“-Technik, viele Bilder</i>	
Literatur	37

Redaktionsschluß: 23.11.1988